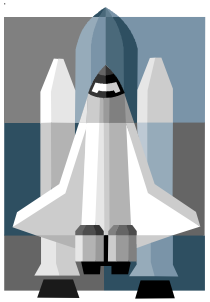
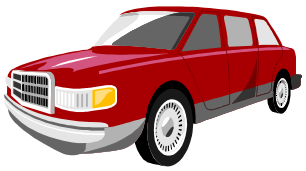
épotecny

Colles, résines et vernis protection
Poudres et paillettes d'argent
Equipements de mélange, de dépose, d'insolation UV/Visible



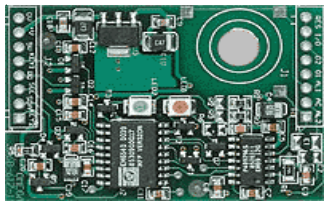
Spatial et Aéronautique

Optique



Automobile

Electronique
grand public



Electronique

Carte à puces

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France
Tel :33(0)1-47-57-54-34 - Fax 33(0)1-47-57-54-74 - E-mail epotecny@epotecny.com - www.epotecny.com

02-2014

Visitez notre site internet

www.epotecny@epotecny.com

Nos coordonnées

Epotecny
9 rue Aristide Briand
92300 LEVALLOIS PERRET
FRANCE

Tél. : +33 (0)1 47 57 54 34
Télécopie : +33 (0)1 47 57 54 74

Si vous avez des questions générales sur EPOTECNY, son activité et ses produits, merci d'écrire à **epotecny@epotecny.com**

Selon le sujet que vous souhaitez aborder, vous pouvez également contacter directement le service concerné :

Service technique : **technique@epotecny.com**
Service commercial : **commercial@epotecny.com**
Service formation : **formation@epotecny.com**

Sommaire

1) RESINES ELECTROCONDUCTRICES

- Bicomposant — page 4
- Monocomposant — page 5

2) RESINES POUR APPLICATIONS OPTIQUES, COLLAGE STRUCTURAL ET MOULAGE UNDERFILL ET RESINES CMS

- Bicomposant — page 6
- Monocomposant — page 7

3) RESINES THERMOCONDUCTRICES

- Bicomposant — page 8
- Monocomposant — page 9

4) VERNIS ELECTROCONDUCTEURS & DILUANTS — page 10

5) RESINES ET VERNIS LEAD FREE — page 11

6) RESINES SILICONE ET POLYURETHANE — page 12

7) RESINES ET VERNIS PHOTOSENSIBLES (UV & VISIBLE)

- Applications optiques — page 13
- Applications électroniques — page 14
- Applications spéciales — page 15

8) POUDRES ET PALLETTES D'ARGENT — page 16

9) EQUIPEMENTS

- Sources de lumière UV/Visible — page 17
- Equipements de mesure, de protection UV, de dépose de mélange — page 18

MAJ 17/02/2014

*RESINES EPOXY ELECTROCONDUCTRICES, BICOMPOSANT**

REF	RAPPORT MELANGE	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
								AVANT TG	APRES TG		
E201	2/3	5 min à 150°C	8 h à 25°C	3 Pa.s	70-80°C	380-400°C	71,5%	40-50.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Collage du silicium sur grille dans la fabrication des semi-conducteurs
E202	1/1	5 min à 150°C	8 h à 25°C	1 Pa.s	70-80°C	380-400°C	72%	40-50.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Collage du silicium sur grille dans la fabrication des semi-conducteurs - Faible taux de volatile - Dépose de gouttes de petite dimension
E203	1/1	25 min à 150°C	8 h à 25°C	2 Pa.s	40-50°C	330-400°C	79%	50-60.10^{-6}/°C	100-120.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Collage sur claviers souples en polyester - Résine souple
E204	1/1	5 min à 150°C	8 h à 25°C	0,75 Pa.s	70-80°C	380-400°C	74,5%	50-60.10^{-6}/°C	170-1800.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Collage de puces en silicium - Résine liquide
E205	1/1	3 min à 150°C	8 h à 25°C	2 Pa.s	70-80°C	390-400°C	71,5%	50-60.10^{-6}/°C	100-120.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Collage circuits polyesters - Réticulation basse température
E206	10/0,8	10 min à 100°C	1 h à 25°C	8 Pa.s	40-50°C	> 350°C	55%	40-50.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<10 mΩ.cm	Collage de fils dorés sur électrodes
E207	10/0,2	48 h à 25°C	6 h à 25°C	3,5 Pa.s	80-100°C	> 350°C	76,5%	40-50.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	0,3 mΩ.cm	Bonne conduction électrique après réticulation ambiante - Conforme norme ESA PSS-01-702
E212	1/1	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	1,5 Pa.s	80-90°C	350-370°c	71%	50-60.10^{-6}/°C	150-180.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Collage de puces en silicium - Sérigraphiable
E212LF	1/1	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	25 Pa.s	70-80°C	380-410°C	70%	55-65.10^{-6}/°C	100-110.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Collage de condensateurs tantale
E212M	1/1	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	0,8 Pa.s	70-80°C			50-60.10^{-6}/°C		<0,5 mΩ.cm	Collage de puces en silicium - Sérigraphiable - Plus fluide que la E212
E212M-1	100/2	5 min à 150°C	1 jour à 25°C	3 Pa.s	70-90°C	390-410°C		40-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Sérigraphie de pistes conductrices ou de plages d'accueil pour le report de puces - Très bonne définition en sérigraphie
E215	2/1	5 min à 100°C	4 h à 25°C	10 Pa.s	70-90°C	390-410°C	73%	40-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Application cartes à puces - Bonne définition en sérigraphie - Réticulation très rapide
E300	1/1	1 h à 200°C	8 h à 25°C	500 Pa.s	60-80°C	350-360°C		80-90.10^{-6}/°C	430-450.10^{-6}/°C	10 à15 Ω.cm	Résine faible coût - Chargée graphite
E301	1/1	24 h à 20°C	1 jour à 25°C	500 Pa.s	70-90°C	350-360°C		80-90.10^{-6}/°C	430-450.10^{-6}/°C	2500 Ω.cm	Réticulation à basse température - Chargée graphite

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 01-2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

*RESINES EPOXY ET POLYIMIDE, ELECTROCONDUCTRICES, MONOCOMPOSANT**

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE en pot	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
							AVANT TG	APRES TG		
E207-1	1 à 7 jours à 25°C	4 h à 25°C	3,5 Pa.s	30-60°C	390-400°C	74%	50-60.10^{-6}/°C	120-140.10^{-6}/°C	<0,2 mΩ.cm	Collage conducteur dans les cartes à puces - Faible viscosité - Réticulation à température ambiante
E208	1 min à 150°C	6 h à 25°C	5,5 Pa.s	70-90°C	390-400°C	74%	40-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Collage sur cartes à puces - Collage de diodes sur clavier souple - Réticulation rapide
E208FV	1 min à 150°C	8 h à 25°C	12,5 Pa.s	70-90°C	390-400°C	75%	40-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Résine fluide - Collage sur cartes à puces, claviers souples
E209	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	10 Pa.s	70-90°C	430-450°C	60%	40-50.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Bonne adhésion sur brasure étain/plomb
E211	10 min à 150°C	7 jours à 25°C	3 Pa.s	70-90°C	420-440°C	75%	40-50.10^{-6}/°C	100-130.10^{-6}/°C	<0,2 mΩ.cm	Condensateurs tantale - Durée de vie en pot supérieure à 7 jours
E211FV	1 min à 150°C	18 h à 25°C	10 Pa.s	70-90°C	390-400°C	75%	40-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Version de la E211 plus réactive
E211HV	1 min à 150°C	21 h à 25°C	13 Pa.s	70-90°C	390-400°C	75%	40-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Version de la E211 plus réactive - Durée de vie en pot > 20 h
E213LF	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	15 Pa.s	70-80°C	390-410°C		40-50.10^{-6}/°C		<0,3 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Collage de condensateurs tantale
E214	5 min à 150°C	24 h à 25°C	25 Pa.s	70-90°C	> 350°C	75%		90-100.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Version monocomposant de la résine E203
E214SC	2 à 3 jours à 20°C	8 h à 25°C	25 Pa.s	40-50°C	> 350°C		40-50.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Monocomposant - Réticualtion à température ambiante
E216HV	10 min à 150°C	7 jours à 25°C	15 Pa.s	70-100°C	420-440°C	79%	40-50.10^{-6}/°C	100-130.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Collage de composants de grande dimension
E216LF	1 h à 150°C	5 jours à 25°C	25 Pa.s	50-80°C	380-410°C		35-45.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<0,3 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Connections électriques
E217	1 h à 150°C	7 jours à 25°C	15 Pa.s	-35 à -25°C	> 350°C	80%		150-180.10^{-6}/°C	<15 mΩ.cm	Collage conducteur de grande souplesse - Destiné aux quartz hautes fréquences
E217LF	1 h à 150°C	5 jours à 25°C	12,5 Pa.s	30-35°C	430°C		60-65.10^{-6}/°C		<1 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Collage de larges puces
E217SC	3 min à 150°C	2 jours à 25°C	15 Pa.s	< -30°C	325°C			140.10^{-6}/°C	<5 mΩ.cm	Collage de condensateurs tantale
E218	15 min à 170°C	24 h à 25°C	15 Pa.s	60-70°C	440°C		55-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	<1000 mΩ.cm	Collage conducteur des terminaisons de composants
P200	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	10 Pa.s	190-210°C	> 550°C	64%	28-30.10^{-6}/°C	90-100.10-6/°C	< 0,5 mΩ.cm	Résine polyimide. Collage conducteur avec tenue à haute température. Réalisation pistes conductrices
P202	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	100 Pa.s	190-210°C	> 550°C		28-30.10^{-6}/°C	90-100.10^{-6}/°C	<1 mΩ.cm	Résine polyimide. Collage conducteur avec tenue à haute température. Réalisation pistes conductrices

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 01-2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecı

*RESINES BICOMPOSANT POUR APPLICATIONS OPTIQUES, COLLAGE STRUCTURAL ET MOULAGE**

REF	RAPPORT MELANGE	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
								AVANT TG	APRES TG		
E501	4/1	12/24 h à 25°C	1 h à 25°C	0,2 Pa.S	50-70°C	310-330°C		70-80.10^{-6}/°C	240-260.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collages optiques - Résine liquide incolore Existe aussi en versions thixotropes non transparentes : E501Si, E501SiT, E501T et E501TT
E504	5/1	48 h à 25°C	2 h à 25°C	4 Pa.S	60-70°C	340-360°C	24%	60-70.10^{-6}/°C	120-140.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Résine semi souple pour enrobage - Norme UL94VO - Liquide - Blanche
E504T	10/0,5	48 h à 25°C	2 h à 25°C	8 Pa.S	70-80°C	340-360°C	27%	60-70.10^{-6}/°C	120-140.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Résine semi souple pour enrobage - Norme UL94VO - Thixotrope - Blanche
E505	10/1	1 min à 150°C	4 h à 25°C	2,5 Pa.S	105-115°C	380-400°C		60-70.10^{-6}/°C	140-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage des fibres optiques dans connecteurs - Fort effet de mesh - Peut être colorée en noire *Existe aussi en versions thixotropes : E505Si, E505SiT, E505T et E505TT*
E507	1/0,28	2 h à 125°C	4 h à 25°C	1,2 Pa.S	105-115°C	380-400°C				10^{16} Ω.cm	Collage de ferrites
E507-4	1/1	10 min à 150°C	8 h à 25°C	22,5 Pa.S	160-170°C	370-380°C	81%	17-20.10^{-6}/°C	65-70.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces
E510	10/1,1	24/48 h à 25°C	1 h à 25°C	6 Pa.S	90-100°C	340-360°C	45%	50-60.10^{-6}/°C	150-180.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Liquide Rigide - Noire
E511	10/0,6	48 h à 25°C	1 h à 25°C	13 Pa.S	60-80°C	340-360°C	45%	50-60.10^{-6}/°C	150-180.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Thixotrope Rigide - Noire
E512	10/2	48 h à 25°C	15 à 30 min à 25°C	5 Pa.S	60-70°C	340-360°C	20%	60-70.10^{-6}/°C		10^{13} Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Liquide - Semi souple - Noire
E512-2	10/0,5	48 h à 25°C	1 h à 25°C	5 Pa.s	60-70°C	340-360°C	20%	60-70.10^{-6}/°C		10^{13} Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Conforme UL94Vo
E513	1/1	20 min à 140°C	8 h à 25°C	30 Pa.s	125-130°C	400-410°C	70%	35-40.10^{-6}/°C	100-120.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Réalisation d'isolateurs haute tension -Très bonne conduction thermique
E514	1/1	2 h à 100°C+4 h à 160°C	8 h à 25°C	100 Pa.s	150-160°C	340-350°C	65%	20-30.10^{-6}/°C	60-70.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs - Dépôt à la goutte - Noire - Haut degré de pureté
E515	4/1	12/24 h à 25°C	1 h à 25°C	40 Pa.s	50-70°C	310-330°C	16%	70-80.10^{-6}/°C	240-260.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Résine très thixotrope pour collage sans fixation spécial - Blanche
E516	100/3	30 min à 120°C	16 h à 25°C	80 Pa.s	70-90°C	400-410°C	73%	30-40.10^{-6}/°C	100-120.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Enrobage d'appareillages à noyau métallique Haute conductivité thermique - Bleue
E520	1/1	3 à 6 h à 25°C	10 min à 25°C	9 Pa.s						10^{13} Ω.cm	Résine transparente et incolore - Prise rapide
E521	3,35/1	2 h à 65°C	20 min à 20°C	27 Pa.s	100°C	340-360°C	44%	50-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Résine de protection, blanche - Faible dilatation thermique
E522	2,43/1	20 min à 65°C	20 à 30 min à 25°C		120°C	340-360°C		70-80.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Résine de protection, blanche - Faible dilatation thermique - haute tenue en température
E525	10/1	45 min à 85°C	4 h à 25°C	30 Pa.s	105-120 °C	400°C		65-70.10^{-6}/°C		10^{13} Ω.cm	Collage structural de grandes pièces - Haute tenue en température
E526	2/1	15 min à 65°C	20 min à 25°C	40 Pa.s	95 °C	400°C		20.10^{-6}/°C		8.10^{14} Ω.cm	Faible coefficient d'expansion thermique. Bonne résistance aux agents chimiques.
E529	2/1	48 h à 25°C ou 2h à 55°C	30 min à 25°C	16 Pa.s	90 °C	>300°C		60.10^{-6}/°C			Collage structural- haute thixotropie - excellente adhesion sur métaux- bonne resistance humidité
E530	1/1	30 min à 125°C+4h à 150°C	18 h à 25°C	11 Pa.s	160-170 °C	380°C		20.10^{-6}/°C	85.10^{-6}/°C		Protection composants-faible viscosité
E531	100/10	24 à 48h à 25°C	60 à 100 min à 25°C	5 Pa.s	90-100 °C	350°C		50-60.10^{-6}/°C		10^{13} Ω.cm	Encapsulation et protection composants- Existe en version Noire
E532	1/1	24h à 25°C ou 30 min à 85°C	25 min à 25°C	21 Pa.s part A et 44 Pa.s part B							Souple 65 shores A- réticualtion température ambiante
E533	1/1	10 min à 25°C- 1min à 65°C	5 min à 25°C	10 Pa.s	8°C					8^{14} Ω.cm	Noire-Fast cure-bonne résistance aux vibrations

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 11-04-2014

épotecny 9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

RESINES MONOCOMPOSANT POUR APPLICATIONS OPTIQUES, COLLAGE STRUCTURAL ET MOULAGE UNDERFILL- ET RESINES CMS**

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE en pot	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
							AVANT TG	APRES TG		
E506	1 min à 125°C	3 jours à 4°C	0,4 Pa.S	80-90°C	350-360°C		60-70.10^{-6}/°C	140-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Enrobage des puces sur cartes à puces-Haut degré de pureté
E506-5	1 h à 135°C	1 mois à 20°C	12 Pa.S	120-135°C	370-390°C		60-80.10^{-6}/°C	170-190.10^{-6}/°C	10^{17} Ω.cm	Protection des puces silicium - Noire-Haute pureté
E506-7	10 min à 100°C	5 h à 20°C	4 Pa.S	60-70°C	370-390°C		55-65.10^{-6}/°C	130-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection des puces silicium - Haute pureté - Haute résistance à l'humidité
E507-3	5 min à 150°C	24 h à 25°C	22,5 Pa.S	160-170°C	350-370°C	72%	15-25.10^{-6}/°C	55-65.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces
E508	5 min à 150°C	6 jours à 20°C	70 Pa.S	145-155°C	> 350°C	75%	18-20.10^{-6}/°C	65-75.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces. Recommandée pppour les puces de grandes dimensions
E508HV	5 min à 150°C	5 jours à 20°C	130 Pa.S	145-155°C	> 350°C		23-25.10^{-6}/°C	85-100.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces. Utilisée pour former le cordon autour de la puce
E517	30 min à 150°C	1 mois à 20°C	50 Pa.S	70-100°C	330-350°C		25-30.10^{-6}/°C	55-65.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage et protection des puces en silicium -Haute pureté - Forte conductivité thermique
E518FC	1 min à 150°C	8 h à 25°C	3,5 Pa.S	40-60°C	350-370°C	59%	30-40.10^{-6}/°C	100-110.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs de type Flip-chip
E519FC	1 min à 150°C	8 h à 25°C	3,5 Pa.S	40-60°C	350-370°C	64%	35-50.10^{-6}/°C	110-120.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection des semi-conducteurs de type Flip-chip - Norme UL94VO
E534	30 min à 130°C	3 jours à 20°C	25 Pa.S	140-150 °C	440°C	65%	25.10^{-6}/°C	120.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Underfill- durcissement rapide - faible Cte
NEA155	10 min à 150°C	4 mois à 25°C	42 Pa.S	50-60°C	360-380°C	6%	90-100.10^{-6}/°C	180-200.10^{-6}/°C	10^{15} Ω.cm	Résine thixotrope rouge pour collage de CMS avant passage à la vague

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny 9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

*RESINES EPOXY THERMOCONDUCTRICES, BICOMPOSANT**

REF	RAPPORT MELANGE	DUREE DE VIE en pot	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
								AVANT TG	APRES TG		
E701	1/1	5 min à 150°C	8 h à 25°C	1,7 Pa.S	70-80°C	420°C		50.10^{-6}/°C	150.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces en silicium - Grise. *Existe aussi en version noire : E701N*
E702	1/1	5 min à 150°C	8 h à 25°C	8 Pa.S	70-80°C	420°C		$50\text{-}60.10^{-6}$/°C	$150\text{-}160.10^{-6}$/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces en silicium - Plus visqueuse que la ref E701 Grise - *Existe aussi en version noire : E702N*
E704	1/1	5 min à 150°C	24 h à 25°C	7 Pa.S	75-85°C	410-420°C		$40\text{-}50.10^{-6}$/°C	$120\text{-}150.10^{-6}$/°C	10^{13} Ω.cm	Protection à la goutte - Collage de thermocouples - Grise *Existe aussi en version noire : E704N*
E705	30/1	5 min à 150°C	4 h à 25°C	50 Pa.S	75-90°C	380-400°C		$30\text{-}40.10^{-6}$/°C	$90\text{-}100.10^{-6}$/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de thermocouples - Très visqueuse - Grise - Existe en version noire
E707	1/1	5 min à 150°C	48 h à 25°C	6 Pa.S	85-95°C	410-420°C	45%	$40\text{-}50.10^{-6}$/°C	$120\text{-}150.10^{-6}$/°C	10^{13} Ω.cm	Collage des barreaux de pesage - Bonne conductivité thermique - Conforme norme ESA PSS-01-702
E707RT	2/1	8-15 jours à 25°C	4 h à 25°C	9 Pa.S	50-70°C	400°C		$50\text{-}60.10^{-6}$/°C	$150\text{-}200.10^{-6}$/°C	10^{13} Ω.cm	Collage thermoconducteur à température ambiante.
E708	10/1,6	12 h à 25°C	1 h à 25°C	3,5 Pa.S	60-80°C	340-350°C	17%	$50\text{-}60.10^{-6}$/°C	$200\text{-}210.10^{-6}$/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces en silicium - Grise - Réticulation à température ambiante- *Existe aussi en version noire : E708N*

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny 9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

*RESINES EPOXY ET POLYIMIDES, THERMOCONDUCTRICES, MONOCOMPOSANT**

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE en pot	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
							AVANT TG	AVANT TG		
E703FC	5 min à 125°C	4 h à 25°C	2,5 Pa.S	70-80°C	350°C	51%	50-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces en silicium - Réticulation très rapide - Peu de volatiles
E703HV	5 min à 150°C	16 h à 25°C	10 Pa.S	70-80°C	> 350°C	51%	50-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces en silicium - Réticulation très rapide - Peu de volatiles - Visqueuse
E703LF	1 min à 140°C	7 jours à 25°C	10 Pa.S	70-80°C	> 350°C		50-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces - Technologie Lead free
E703SC	5 min à 125°C	5 jours à 25°C	12 Pa.S	70-80°C	> 350°C		50-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces en silicium - Réticulation très rapide - Peu de volatiles - Visqueuse
E704LF	1 min à 140°C	5 jours à 25°C	7,5 Pa.S	70-80°C	350-380°C		50-60.10^{-6}/°C	150-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de puces - Technologie Lead free
E707-2	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	8 Pa.S	90-100°C	370-390°C	42%	40-50.10^{-6}/°C	120-150.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Version monocomposant de la ref E707
E707-2FV	30 min à 150°C	5 jours à 25°C	17 Pa.S	90-100°C	370-390°C	42%	40-50.10^{-6}/°C	120-150.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Version visqueuse de la E707-2
E707-2LF	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	12 Pa.S	90-100°C	> 380°C		40-50.10^{-6}/°C	120-150.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Collage de jauges de contraintes - Technologie Lead free
E707-3	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	20 Pa.S	90-100°C	370-390°C		55-65.10^{-6}/°C	130-160.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Protection au trempé de petits composants électroniques
P101	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	11 Pa.S	175-205°C	576°C	60%	25-27.10^{-6}/°C	48-50.10^{-6}/°C	10^{13} Ω.cm	Résine polyimide. Collage thermoconducteur avec tenue à haute température
P102	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	17 Pa.S	250-275°C	575°C				10^{13} Ω.cm	Résine polyimide. Collage thermoconducteur avec tenue à haute température

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny 9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 -epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

VERNIS ELECTROCONDUCTEURS & DILUANTS

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	RESISTIVITE	UTILISATIONS
V401-1	10 min à 150°C	1 an à 25°C	9 Pa.S				< 100 mΩ.cm	Vernis graphite - Bonne adhésion sur PET
V402	1 h à 150°C	1 mois à 25°C	10 Pa.S	80-95°C	350°C	69%	0,2 mΩ.cm	Vernis argent - Excellente adhésion au tantale
V403-1	1 min à 150°C	1 an à 25°C	2,5 Pa.S			60%	< 0,1 mΩ.cm	Vernis argent - Bonne adhésion sur polycarbonate
V405-1	15 min à 150°C	1 an à 25°C	0,8 Pa.S			50%	< 0,5 mΩ.cm	Vernis argent - Excellente adhésion au tantale
V407	1 h à 120°C	1 an à 25°C	5 Pa.S	60°C	350°C	66%	0,03 mΩ.cm	Vernis argent - Bonne adhésion sur polyester
V408	40 min à 150°C	16 h à 25°C	2 Pa.S		400-450°C		< 0,2 mΩ.cm	Vernis argent - Métallisation des trous vias
V409	40 min à 150°C	16 h à 25°C	1,6 Pa.S		400-450°C		< 0,2 mΩ.cm	Vernis argent - Métallisation des trous vias
V410	40 min à 150°C	16 h à 25°C	1,2 Pa.S		400-450°C		< 0,2 mΩ.cm	Vernis argent - Métallisation des trous vias

Des diluants : D401 - D402 - D403 -D404 peuvent être utilisés jusqu'à obtention de la viscosité recherchée pour une application particulière. Ils peuvent être aussi utilisés pour éliminer les dépôts avant séchage ainsi que pour le nettoyage du matériel d'application

Maj 01-2014

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

*RESINES ET VERNIS EPOXY POUR LA TECHNOLOGIE SANS PLOMB (LEAD FREE)**

REF	CARACTERISTIQUES	RETICULATION	VISCOSITE	RESISTIVITE	CONDUCTIBILITE THERMIQUE	UTILISATION PRINCIPALE
RESINES EPOXY ARGENT ELECTROCONDUCTRICES, LEAD FREE						
E212LF	Bicomposant, Pot life 2 jours, Facile à appliquer par dispensing	de 80°C à 200°C	25 Pa.S	<0,3 mΩ.cm	---	Collage de condensateurs tantale
E213LF	Monocomposant, Pot life 2 jours, Facile à appliquer par dispensing	de 75°C à 200°C	25 Pa.S	<0,3 mΩ.cm	2,5-3 W/(m.°K)	Collage de condensateurs tantale
E216LF	Monocomposant, Pot life 5 jours, Facile à appliquer par dispensing	de 150°C à 200°C	15 Pa.S	<0,3 mΩ.cm	---	Connections électriques
E217LF	Monocomposant, Pot life 5 jours, Facile à appliquer par dispensing	de 150°C à 200°C	12,5 Pa.S	<1 mΩ.cm	2-2,5 W/(m.°K)	Collage de large puces
VERNIS ARGENT ELECTROCONDUCTEURS, LEAD FREE						
V402LF	Monocomposant, Stabilité 3 mois t° inférieure à 10°C, Flexible	de 150°C à 180°C	10 Pa.S	0,2 mΩ.cm	---	Termination composants CMS
V403LF	Monocomposant, Stabilité 9 mois t° inférieure à 5°C, Flexible	de 150°C à 180°C	3,7 Pa.S	<0,3 mΩ.cm	---	Termination composants CMS
V404LF	Monocomposant, Stabilité 3 mois t° inférieure à 10°C, Flexible	de 150°C à 180°C	10 Pa.S	0,2 mΩ.cm	---	Termination composants CMS
RESINES EPOXY THERMOCONDUCTRICES,LEAD FREE						
E703LF	Monocomposant, Pot life 1 semaine, peu de volatile	de 75°C à 140°C	10 Pa.S	---	1 W/(m.°K)	Collage de puces
E704LF	Monocomposant, Pot life 1 semaine, peu de volatile	de 75°C à 140°C	7,5 Pa.S	---	0,7 W/(m.°K)	Collage de puces
E707- 2 LF	Monocomposant, Stabilité 3 mois à 20°C, très réactive	de 125°C à 200°C	12 Pa.S	---	1-1,5 W/(m.°K)	Collage de jauges de contraintes

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 01-2014

épotecny 9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

RESINES SILICONE ET POLYURETHANE

REF	NBRE DE COMP.	RAPPORT MELANGE	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
									AVANT TG	APRES TG		

RESINES POLYURETHANES POUR MOULAGE

PU201B	2	100/15,4	24 à 48 h à 25°C	1 h à 25°C	30 Pa.S	-40°C					$4,7.10^{12}$ Ω.cm	Encapsulation - Translucide Conforme UL94VO
PU201N	2	100/4	24 à 48 h à 25°C	1 h 30 à 25°C	70 Pa.S	-40°C					$2,6.10^{11}$ Ω.cm	Encapsulation - Couleur noire - Conforme UL94VO - Haute conduction thermique
PU202	2	1/1	24 à 48 h à 25°C	5min à 25°C	8 Pa.S	-40°C			230ppm/°C		$4,.10^{13}$ Ω.cm	collage et Encapsulation - Noire- faible retrait- 130 kg Al/Al
PU202T	2	1/1	24 à 48 h à 25°C	5min à 25°C	70 Pa.S	-40°C			230ppm/°C		$4,6.10^{13}$ Ω.cm	Encapsulation - Translucide- faible retrait- 130 kg Al/Al

RESINE SILICONE POUR COLLAGE STRUCTURAL

S303N	2	100/3,4	2 h à 85°C	4 h à 25°C	8 Pa.S	-64°C			2.10^{-4}/°C		$2,5.10^{15}$ Ω.cm	Encapsulation - Couleur noire - Bonne conduction thermique
S323N	2	1/1	2 h à 85°C	24 h à 25°C	8 Pa.S	-64°C	> 500°C	68%	200.10^{-6}/°C		$2,5.10^{15}$ Ω.cm	Encapsulation - Couleur noire - Bonne conduction thermique
S317N	2	1/1	1 à 3 h à 150°C	10 jours à 20°C	10 Pa.S	40°C						Encapsulation - Couleur noire - conservation 6 mois à T< 10°C
S325N	2	1/1	1 à 3 h à 150°C	10 jours à 20°C	10 Pa.S	-64°C			200 ppm/°C			Encapsulation- Conform UL94V0
S227B	2	4/1	15 min à 25°C	<10 min à 25°C	2,5 Pa.S	-64°C			550 ppm/°C		$2,5.10^{15}$ Ω.cm	Encapsulation - Bonne conduction thermique- 55 shores A après 12 hà 25°C
REF	**NBRE DE COMP.**	**RAPPORT MELANGE**	**RETICULATION Recommandée**	**DURETE**	**VISCOSITE**	**Tg**	**Light transmission**				**index refraction**	**UTILISATIONS**

RESINE SILICONE POUR LED

S110	2	1/1	2 h à150°C	60 shores A	2,2 Pa.S	-64°C	95% at 480 nm				1,41	Encapsulation Led- Ne jaunit pas - bonne résistance à l'humidité

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 06/02/2014

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

épotecny 9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

Ref	Couleur	Indice	Viscosité en Pa.s	Dureté en Shores D	Densité en g/cm³	Adhésion sur			Module d'élasticité en kg/cm²	Traction en kg/cm²	Elongation en %	UTILISATIONS
						Verre	Métal	Plastique				
RESINES RETICULABLES UV- Norland *www.norlandproducts.com* **et Epotecny**												
NOA 60	Transparent	1,56	0,3	80	1,15	++	++	+	10000	200	35	Collage de doublets, de prismes
NOA 61	Transparent	1,56	0,3	85	1,13	+++	+++	+	10500	200	38	Applications militaires - Collage de doublets, de prismes. Faible retrait
NOA 63	Transparent	1,56	2	85	1,12	++	++	+	16800	300	6	Collage épais. Bonne transmission dans les UV
NOA 65	Transparent	1,52	1,2	50	1,12	++	++	+	1400	105	80	Collage souple. Faibles tensions
NOA 68	Transparent	1,54	5	60	1,12	+++	++	+++	1400	150	80	Collage souple. Verre, plastique, CAB, polycarbonate et acrylique
NOA 68T	Transparent	1,54	20	50	1,12	+++	++	+++	---	---	---	Haute viscosité. Collage souple. Verre, plastique, CAB, polycarbonate et acrylique
NOA 71	Transparent	1,56	0,2	80	1,1	+++	+++	+	3850	90	43	Collage verre/verre et verre/métal
NOA 73	Transparent	1,56	0,13	55	1,1	+++	++	+	112	10	16	Collage souple. Très faible viscosité, film très mince
NOA 74	Transparent	1,56	0,1	30	1,1	+++	++	+++	203	15	10	Collage souple - Film mince
NOA 81	Transparent	1,56	0,3	85	1,13	+++	+++	+	14000	200	25	Réticualtion rapide. Collage verre/métal. Rigide
NOA 84	Transparent	1,46	0,04-0,075	55	1,1	+++	+	+++	80	45	57	Faible indice de réfraction. Collage et coating plastique/verre
NOA 85	Transparent	1,46	0,2	40	1,5	+++		+++	9340		111	Faible indice de réfraction. Très bonne adhésion plastique/verre
NOA 88	Transparent	1,56	0,2	85	1,1	+++	+++	+	7840	130	43	Faible dégazage pour l'industrie aérospatiale. Bonne transmission dans l'UV
NOA 89	Transparent	1,51	0,02	40	1,13	+++	++	+	---	---	---	Résine très liquide - Collage souple
NOA 131 à NOA 138	Transparent	1,31 à 1,38	0,015 à 0,04	60		+++	++	+				Faible indice de refraction collage vere/verre
OAD 423	Incolore	1,52	10	50	1	++	+++	+	---	30	120	Film souple transparent. Collage de fibres optiques
OAD 424	Incolore	1,52	10,5	85	1,1	++	+++	+	---	150	20	Film rigide transparent. Collage de fibres optiques
OAD 427	Incolore	1,52	5	80	1,1	++	+++	+	---	----	100	Film rigide transparent. Collageverre/verre
OAD 450	Incolore	1,56	2,5	70	1,1	+++	++	+	---	150	100	Réticulation rapide. Collage de lentilles
OAD 452	Incolore	1,56	2,5	65	1,1	+++	++	+	---	150	100	Réticulation rapide. Collage de lentilles, encapsulation des diodes électroluminescentes
OAD061	Transparent	1,56	0,35	80	1,1	+++	+++	+	---	200	35	Assemblage de composants optiques, lentilles, prismes - Parfaitement transparent à T>200°C
DOP100	Incolore	1,41	5	70 Shores A	1,1	+++	+++	+++	140	29	328	Faible indice de réfraction - Connections de fibres optiques
RESINES RETICULABLES UV OU VISIBLE- Norland *www.norlandproducts.com*												
NOA 72	Transparent	1,56	0,15	75	1,1	+++	++	+++	168	30	34	Très faible viscosité. Collage verre, plastique, polycarbonate, CAB. Réticulation UV ou Visible
NOA 75	Transparent	1,52	0,1	25	1,1	+++	++	+++	182	11	7	Collage souple. Très faible viscosité, film très mince. Réticulation UV ou Visible
NOA 76A	Transparent	1,51	3,5-5,5	30	1,1	+++	++	+++	50	30	47	Collage verre/plastique. Réticulation UV ou Visible
NOA 78	Transparent	1,5	10	55	1,1	+++	++	+++	60	40	57	Collage plastique/plastique. Réticulation UV ou Visible. Forte viscosité

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

Ref	Couleur	Indice	Viscosité en Pa.s	Dureté en Shores D	Densité en g/cm³	Adhésion sur			Module d'élasticité en kg/cm²	Traction en kg/cm²	Elongation en %	UTILISATIONS
						Verre	Métal	Plastique				
RESINES RETICULABLES UV ET/OU THERMIQUES - Norland *www.norlandproducts.com*												
NOA 83H	Transparent	1,56	0,25	80	1,1	+++	+++	+	11200	240	30	Réticulation rapide UV ou thermique. Collage possible de matières opaques
NEA 121	Transparent	1,56	0,3	80	1,1	+++	+++	+	11200	200	30	Collage de fils sur circuit imprimé. Collage CMS - Existe aussi en version colorée en rouge
NEA 123	Translucide	----	200	60	1,1	+++	++	+++	3500	200	60	Résine visqueuse pour le collage de composants. Large gamme de couleurs (rouge, bleu, vert) et de viscosités
NEA 155	Rouge	----	150	90	1,2	+++	++	+++	----	----	----	Pâte thixotropique pour le collage des CMS
NEA123HGA	translucide	----	200	60	1,1	+++	++	++	22470	265	25	Faible dégazage
NEA123SHGA	translucide	----	55	80	1,1	+++	++	++	----	265	----	Faible dégazage
RESINES RETICULABLES UV - Epotecny												
OAD 381	Jaune	----	0,4	70	1,1	+++	+	+++	---	250	20	Très fluide. Remplissage de faible cavité
OAD 382	Jaune	----	2,5	30	1,1	+	+	+++	---	100	60	Thixotropique. Glob top épais, souple
OAD 384	Grise	----	9	85	1,5	++	+++	+++	---	395	1,5	Glob top de forte épaisseur. Réalisation des anneaux pour les applications de potting
OAD 385	Incolore	----	2,2	70	1,1	++	+++	++	---	250	10	Collage de matériaux opaques ou non
OAD 386	Grise	----	2,5	85	1,4	++	++	++	---	400	2	Résine fluide pour application Dam & Fill
OAD 386-1	Grise	----	2,7	80-85	1,4	++	++	++	---	400	2	Résine fluide pour application Dam & Fill - Excellente tenue en humidité et cyclage thermique
OAD 387	Grise	----	15	85	1,4	++	++	++	---	400	2	Résine thixotropique pour application Dam & Fill
OAD 387-1	Grise	----	17	80-85	1,4	++	++	++	---	400	2	Résine thixotropique pour application Dam & Fill - Excellente tenue en humidité et cyclage thermique
OAD 388	Incolore	----	1,5	30 Shores A	1,1	++	+++	++	---	----	----	Résine souple pour collage ou enrobage de composants électroniques
OAD 393	Incolore	----	0,2	60	1,14	++	+++	++	---	----	----	Vernis de protection. Dépôt à la tournette
OAD 394	Grise	----	20	70	1,52	+++	+++	++	---	395	1,5	Thixotropique. Protection des puces sur cartes bancaires et télécartes
OAD 395	Incolore	----	0,15	50	1,15	+++	+++	++	---	----	----	Liquide. Protection des puces sur cartes bancaires et télécartes
OAD 395-1	Jaune	----	0,35	80	1,1	++	+++	+++	---	400	4	Remplissage de cavité de petite taille. Protection de micro-éléments
OAD 396	incolre		75	70 shores A	1	+++	++	+++				UV flexible acrylate pour encapsualtion puce- Glob Top
OAD 397	Incolore	----	2,5	80	1,4	+++	+++	++		----	----	Fill application carte à puce -Bonne résistance humidité et cycles thermiques
DB2001	Noire	----	6	80	----	+++	++	+++	----	434	----	Vernis noir pour la protection et l'encapsulation de composants - Conforme aux normes UL94v-0 et 94v-1
VERNIS SERIGRAPHIABLES - Epotecny												
V691 UV	Bleue	----	3	---	1,1	+++	++	+++	----	110	20	Protection des claviers souples. Bonne adhésion sur le mylar et la polycarbonate
V692 UV	Verte	----	6	---	1,1	+++	+++	+++	----	70	60	Protection des claviers souples. Bonne adhésion sur le mylar et la polycarbonate
V693 UV	Bleue	----	8	---	1,3	+++	+++	++	----	80	40	Très bonne adhésion sur cuivre, verre époxy et aluminium. Strippable à la soude

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

Maj 02/2014

Ref	Couleur	Indice	Viscosité en Pa.s	Dureté en Shores D	Densité en g/cm^3	Adhésion sur			Module d'élasticité en kg/cm^2	Traction en kg/cm^2	Elongation en %	UTILISATIONS
						Verre	Métal	Plastique				

RESINES RETICULABLES UV - APPLICATIONS SPECIALES- Norland *www.norlandproducts.com*

UVS 91	Translucide	----	100	55	1,14	+++	++	+++	3150	200	58	Résine sérigraphiable. Scellement des afficheurs à cristaux liquides
NBA107	Transparent	1,51	0,3	15	1,2	+++	+++	+	----	----	----	Blocage temporaire à froid des lentilles sur support métallique de polissage. Décollement dans l'eau savonneuse
NBA108	Transparent	1,51	0,5	25	1,2	+++	+++	+	----	----	----	Meilleure adhérence que la NBA107 - Décollement à l'acétone - Blocage temporaire à froid des lentilles de grande taille sur support métallique de polissage
IML150	Incolore	1,52	1	----	1,14	----	----	----	----	----	----	Liquide d'indice
NCA 130	Argent	----	10	----	----	+++	++	++	----	----	----	Résine électroconductrice pour dissipation statique

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02/2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

POUDRES ET PAILLETTES D'ARGENT

POUDRES ET PAILLETTES D'ARGENT

REF	ASPECT	GRANULOMETRIE MOYENNE en microns	GRANULOMETRIE MAXIMUM en microns	DENSITE TASSEE	TENEUR EN CUIVRE ppm	TENEUR EN CHLORE ppm	TENEUR EN SODIUM ppm	TENEUR EN POTASSIUM ppm	TENEUR EN ARGENT %	CARACTERISTIQUES

POUDRES D'ARGENT

PO 0.8	Poudre	0,8	100	1,3	< 300	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Cristaux fins. Effet épaississant plus marqué sur les pâtes polymères. Haute pureté ionique
PO 1.0	Poudre	1,0	100	1,8	< 300	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Cristaux un peu plus gros. Plus facilement dispersable dans les pâtes polymères
PO 1.2	Poudre	1,2	100	2	< 10	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Cristaux plus gros encore plus facilement dispersables, donnant des pâtes plus fluides après broyage
PO 10	Poudre	1	100	3	< 50	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Destinée à la réalisation de pistes conductrices sur les claviers souples
PO 11	Poudre	1	40	3	< 50	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Destinée à la réalisation de pistes conductrices sur les claviers souples. Réalisation d'anodes de condensateurs
PO 12	Poudre	1,2	100	3	< 10	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Réalisation d'anodes de condensateurs
PO 13	Poudre	13	40	3	< 10	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Poudre d'argent facilement dispersable

PAILLETTES D'ARGENT

PA 01	Paillette	14	63	2,65	< 300	< 10	< 10	< 10	> 98,8	Haute pureté ionique.
PA 02	Paillette	6	63	3,2	< 300	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Très bonne pour l'utilisation dans les résines en solvant de type polyester acrylique ou phtalique
PA 03	Paillette	6	40	3,2	< 300	< 10	< 10	< 10	> 98,8	Facilement dispersable
PA 04	Paillette	5	25	5,4	----	----	----	----	> 99,8	Haute densité - Haute conductibilité électrique et thermique
PA 05	Paillette	8	63	3,7	< 300	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Densité tassée moyenne. Haute pureté ionique
PA 06	Paillette	6	40	3,8	----	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Destinée à la réalisation de pistes conductrices sur les claviers souples. Réalisation d'anodes de condensateurs
PA 07	Paillette	7	63	3,75	----	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Réalisation d'anodes de condensateurs
PA 08	Paillette	8	40	3,5	< 10	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Destinée à la réalisation de pistes conductrices sur les claviers souples. Réalisation d'anodes de condensateurs
PA 09	Paillette	4	40	4,5	< 10	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Permet un bon étalement malgré la viscosité obtenue assez élevée
PA 10	Paillette	10	40	2,9	----	< 10	< 10	< 10	> 99,8	La finesse permet d'obtenir des surfaces très lisses
PA 11	Paillette	4	40	5,5	----	----	----	----	> 99,8	Haute conductibilité électrique et thermique
PA 14	Paillette	14	65	2,65	< 300	< 10	< 10	< 10	> 99,8	Meilleure en conduction électrique. Pâte polymère épaisse

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

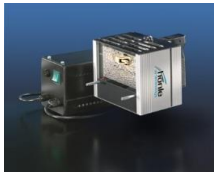
Maj 01-2014

EQUIPEMENTS
SOURCES UV/VISIBLE

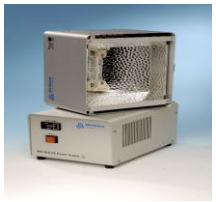
SOURCES UV/VISIBLE : de surface, de table

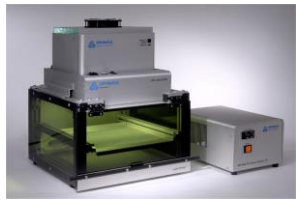
UVAHAND 100
Source UVA - Economique
Portative-polyvalente
Surface d'exposition: 160*160 cm

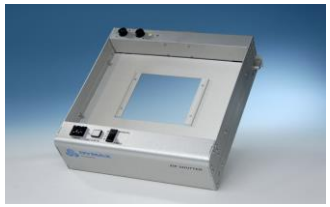
Intensité UV : 120 mW/cm²

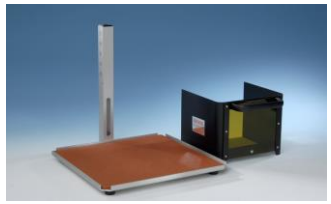


2000-PC ET 5000-PC
Source UV modulable
Surface d'exposition 200x200mm ou 127x127mm
Cabine avec rideau d'obturation optionnel
Ecran amovible avec potence optionnel
Intensité UV : de 75 à 225 mW/cm²
Ampoule métal halide









SOURCES UV/VISIBLE : Sources ponctuelles

LC 8
Forte puissance : 4,5 W/cm2
Intensité ajustable de 0 à 100%
Large choix de guide de lumière
simple, bi et triple brins
Durée de vie de la lampe : 4000 heures

BLUEWAVE 75
Haute intensité : 9 W/cm2
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Large choix de guide de lumière
simple, bi et triple brins
Utilisation simple

BLUEWAVE 200
Très haute intensité : 17 W/cm2
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Large choix de guide de lumière
simple, bi et triple brins
Utilisation simple
Ajustable de 1% à 100%

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.
* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny
9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

RADIOMETRE UV- PROTECTIONS UV
DISTRIBUTEUR DOSEUR - MELANGEUR

RADIOMETRE UV

ACCUL-CAL50

Analyse de la bande spectrale
320 à 395 nm
Mesure des intensités de 1 mw/cm^2
à 40W/cm^2

PROTECTION UV

LUNETTES

Filtrage de 200nm à 540nm
Resistante aux chocs
Conforme aux normes ANSI 787.1.

PLAQUES DE PROTECTION

Filtrage de 200nm à 540nm
Resistantes aux chocs
Couleur : brun
Taille 1000x1000x4 mm
Découpe possible par vous même selon vos besoins

EQUIPEMENTS DE MISE EN ŒUVRE

DOSEUR

Pression 0-7 bars ou 0-1 bars selon la viscosité
Fonctionnement continu ou temporisé
Venturi
Temporisation et affichage digital

MELANGEUR PLANETAIRE
PRESSE TRANSFERT

Mélange ultra rapide, sans bulle
Compact, de table
Dimensions : 25,5x21x29 cm
Poids: 17kg
Pour époxies, silicones…..

Mise en seringue facile et rapide grâce à la presse transfert

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com